

## 開催決定

### MacDermid's Professional Development Seminar Series Dynamic Chemistries for Electronics – Vol.1

## 第一回 プリント基板めっき技術セミナー in Kawasaki

日時： 2015年5月29日(金) 9:00～16:45

場所： ホテルKSP

定員： 申込先着50名

セミナー対象者：

プリント基板製造関連企業の材料技術部門、  
生産技術部門、研究開発部門の担当者様

#### ごあいさつ

マクダーミッドの表面処理技術は日々進化しています。米国本社等から各分野のスペシャリストが参りまして最先端の技術をご紹介します。また、特別講師として株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社より八甫谷明彦氏をお招きしております。ぜひご来場をご検討ください。お待ちしております。

代表取締役社長 ジュリアン・ベイショア

#### プログラム

- ・基板表面銅厚低減を可能にする最新ビアフィルめっき技術
- ・基板厚変化に対応したスルーホールフィリングめっき
- ・[特別講演]IoT、M2Mにおけるモジュール実装技術のご紹介
- ・プリント基板の市場動向
- ・低エッチブラックホールプロセスの高難度基板への適用
- ・ICパッケージ/ビルドアップ基板対応 セミアディティブプロセス 先端技術
- ・オキシド代替最新技術 高周波対応「M-Speed」のご紹介
- ・サプライチェーン戦略
  - OEMとのさらなるコラボレーションをめざして

ほか



お問い合わせは： 日本マクダーミッド株式会社  
〒213-0012神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1 KSP C-7F  
TEL: 044 - 820 - 1181 FAX: 044 - 812 - 4485

